

앰코 첨단 패키징, 미래 자동차를 구현하는 힘

2023년 6월 13일, 미국 애리조나 템피 -- 반도체 패키징 및 테스트 외주(OSAT) 업계의 선두주자 앰코테크놀로지(Nasdaq: AMKR)가 미래의 자동차를 실현하기 위한 최첨단 패키징 혁신을 추진하고 있습니다.

차량용 반도체 판매 증가에서 유추할 수 있듯이 향상된 자동차 경험은 지난 몇 년 동안 극적으로 진화했습니다. 차량용 반도체 시장 규모는 2015년 약 300억 달러에서 2022년 680억 달러로 두 배 이상 성장했고, 앞으로도 몇 년간 연평균 10% 중반대의 성장률을 기록하며 반도체 업계에서 가장 높은 성장세를 보일 전망입니다. 이러한 성장이 가능한 것은 자율 기능, 디지털 제어 시스템, 차량 전기화에 대한 수요가 늘고 있기 때문입니다. 40년 이상의 자동차 시장 경험을 바탕으로 차량용 OSAT 업계를 선도하는 앰코는 세계 각국에 기반을 두고 글로벌 사업을 뒷받침하는 동시에 지역 공급망을 활성화하여 차량용 반도체 콘텐츠의 가속화로 인한 성장에서 기회를 포착하기 유리한 위치에 있습니다.

글로벌 규제와 소비자 선호도 변화에 발맞춰 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS)과 완전 자율주행으로 전환이 이루어지고 있으며, 이에 따라 자동차 제조사들은 표준 모델의 안전 및 편의 기능을 업그레이드하게 되었습니다. 첨단 패키징 솔루션을 사용하면 ADAS를 통해 주차 보조, 차선 위치 지정, 충돌 방지 등 주행 과정의 여러 측면을 자동화할 수 있습니다. ADAS 기술은 레이더, LIDAR, 초음파, 이미지 센서 같은 여러 센서를 사용하여 차량의 안전성을 향상시킵니다. 차량용 패키지의 인터커넥트로 와이어 본드가 주로 사용되고 있지만, ADAS 모듈에는 플립칩 BGA, 웨이퍼 레벨 팬아웃, 플립칩 CSP 같은 첨단 인터커넥트 기술이 점점 많이 사용되고 있습니다. ADAS 프로세서를 위한 첨단 실리콘 노드가 급성장하고 있으며, 앰코는 이미 7nm를 생산 중이고 차량용 애플리케이션에 5nm 솔루션을 빠르게 적용할 예정입니다.

소비자들은 재미있고 유익한 몰입형 인터랙티브 차량 내 경험을 원합니다. 이러한 디지털 제어 센터 수요 충족을 위해 앰코는 원활한 연결, 직관적인 인터페이스 및 개인화된 경험을 제공하는 첨단 인포테인먼트 및 텔레매틱스 패키지 솔루션을 지속적으로 개발하고 있습니다. 이러한 솔루션에는 패넬 및 헤드업 디스플레이, 내비게이션 시스템, 차량과 사물 간 연결 시스템을 구현하게 해주는 플립칩, SiP(System in Package), MEMS, 센서가 포함됩니다.

세계 각국의 정부가 탄소 배출 감축 정책을 시행하고 지속 가능한 교통수단을 장려하는 정책을 시행하면서 차량 전기화로 전환이 급속도로 추진력을 얻고 있습니다. 앰코는 배터리에서 전기 구동 모터로의 전력 변환을 관리하는 xEV 솔루션, 비전기 차량의 연료 소비 및 탄소 배출 관리 및 감축에 사용되는 파워트레인 솔루션을 통해 이러한 수요 증가에 대응하고 있습니다. 또한 현재와 미래에 지속

가능하고 효율적인 차량의 요구를 충족하기 위해 실리콘 카바이드 전력 장치 및 모듈에 대한 첨단 패키징과 MEMS 기술을 통해 업계를 지속적으로 지원하고 있습니다.

자동차 산업에서 수십 년 경험을 쌓은 앰코는 차량용 OSAT 업계 1 위입니다. 한국의 최첨단 R&D 센터와 함께 유럽, 일본, 동남아시아 전역에 전략적인 제조 거점을 두고 자동차 업계의 엄격한 성능과 신뢰성 요건을 충족하기 위해 공장 자동화 및 기타 인더스트리 4.0 실천에 지속적으로 투자하고 있습니다. 미국에 본사를 둔 앰코는 시장 성장에 따라 미국 시장에 전력 모듈 제조를 포함한 자동차 솔루션 추가에 유리한 위치에 있습니다. 또한 앰코는 글로벌 지원 및 세계 각지의 거점을 통해 안정적인 공급과 함께 경쟁 우위 확보를 위한 차세대 자동차 솔루션을 원하는 현지 자동차 제조업체들을 지원할 수 있습니다.

앰코 사업 부문 총괄 Kevin Engel EVP 는 "앰코는 자동차 업계에서 오랜 시간 신뢰할 수 있는 파트너로서 입지를 다지고 리더십을 보여왔습니다. 이는 인프라와 R&D 에 지속적으로 투자하고, 품질을 최우선으로 생각하고, 미래의 자동차 구현에 기여할 수 있도록 기술 부문에서 독보적인 입지를 구축해온 리더십의 결과입니다."라고 말했습니다.

NVIDIA 의 자동차 하드웨어 및 시스템 부문 수석 부사장인 Gary Hicok 은 "자동차 산업이 소프트웨어 정의 자동차를 향해 나아가면서 차량에 첨단 주행 시스템을 장착하기 위해 필요한 처리 능력이 커지고 있습니다. 이에 따라 강력한 디바이스 패키징을 갖춘 복잡한 첨단 기술 플랫폼의 필요성이 점점 증가하는 중입니다. 정교한 설계와 패키징 역량을 보유한 앰코는 신뢰할 수 있는 자동차 패키징 기술 공급업체입니다."라고 말했습니다.

앰코의 자동차 산업 기술역량은 amkor.com/automotive/에서 자세히 알아볼 수 있습니다.

앰코테크놀로지 소개

앰코테크놀로지는 세계 최대 규모의 반도체 패키징 및 테스트 서비스 제공업체 중 하나로, 1968 년 설립되어 IC 패키징 및 테스트 아웃소싱을 선도하고 있습니다. 현재 앰코는 세계 유수 반도체 기업, 파운드리 및 전자제품 OEM 의 전략적 제조 파트너로서 아시아, 유럽, 미국의 주요 전자제품 제조 지역에서 생산시설, 제품 개발 센터, 영업 및 지원 사무소를 운영하고 있습니다. 더 자세한 정보는 www.amkor.com 에서 확인할 수 있습니다.

미래예측진술에 대한 면책조항

본 보도자료는 연방증권법에 의거해 작성된 미래예측진술을 포함하고 있으며 차량 탑재 반도체, 기대 성장을 지원하기 위한 투자에 대한 진술이 이에 해당한다. 미래를 예측하는 서술에 과도하게 의존하지

않도록 주의가 필요하다. 본 보도자료의 모든 미래예측진술은 당사가 현재 가지고 있는 기대, 예측, 추정, 가정에 근거해 작성되었다. 이러한 진술은 위험과 불확실성을 내포하고 있으며 실제 결과와 사건은 현재 예상되는 것과 실질적으로 다를 수 있다. 이 진술에 명시된 사건의 결과에 영향을 미칠 수 있는 위험 요소는 증권거래위원회에 제출되거나 제공된 회사 보고서에 명시되어 있다. 당사 또는 당사 대리인이 작성한 모든 미래예측진술은 이 주의문에 의해 그 전체가 명시적으로 제한된다. 당사는 관련 법률에서 요구하는 경우를 제외하고, 본 보도자료 날짜 이후 발생하는 사건이나 상황을 반영하기 위해 미래예측진술을 검토하거나 개정할 의무가 없다.

연락처

투자자정보

Jennifer Jue

투자자 관계 및 재무 이사

480-786-7594

jennifer.jue@amkor.com

언론관계

Christina Parsons

마케팅 커뮤니케이션팀 수석

480-786-7653

christina.parsons@amkor.com

소셜미디어: @amkortechology